

<b>CPU 主处理器</b>	意法半导体 ARM Cortex-M4 MCU+FPU 处理器，主频 180MHz，工业级； 运行实时固件程序，负责各种 ADC 数据采集、软件数字滤波、软件量程控制、软件增益控制等；
<b>ADC</b>	4 片独立 ADI 公司 24 位高精度 ADC；公用一个时钟，可进行 4 通道并行/同步采集；
<b>模拟输入</b>	4 路差分模拟输入，每路可编程配置输入类型；带两级 PGA 程控放大器；
	差分电压信号 0~5V，0~10V，±1V，±5V，±10V；
	标准电流信号 4~20mA；0~24mA；
	温度信号 RTD 三线制测温 Pt100、Pt1000；
	温度信号 K 型热电偶； 称重传感器输入；
<b>硬件通讯接口</b>	1 路 100Base-T 以太网接口；（标配）
	1 路 RS-485 接口，光电隔离；（选配）
	1 路 RS-232 接口；（选配）
	1 路 CAN2.0B 接口，光电隔离；（选配）
<b>主要软件特性</b>	提供 Linux 下全部接口驱动程序函数库与操作说明；
	提供 Linux Qt 测试程序（数据采集与波形显示、ADC 配置等功能）；
	提供测试程序源码；
	提供 windows 应用程序（数据采集与波形显示、ADC 配置等功能）
<b>通信协议</b>	TCP/IP、UDP 协议；
	Modbus RTU；（选配）
	CAN DeviceNET；（选配）
<b>电源供电</b>	输入电源：±15V/0.3A，±5V 0.5A，5V 0.5A；（另有专用网络电源模块供选用）
<b>外形尺寸</b>	147mmX100.5mm
<b>安装方式</b>	DIN 41612 96 芯标准板对板对接，提供电气外壳。
	单板使用可螺孔安装：M3×4 螺孔；
	多模块底板螺孔安装：M3×16 螺孔；
	通过大底板的底部安装板，标准导轨安装；
<b>存储温度范围</b>	-40~+125℃
<b>工作温度范围</b>	-40~+85℃
<b>典型应用</b>	嵌入式控制系统
	数据采集系统 DAS
	仪器、仪表系统，工业过程仪表
	高精度称重系统
	工业控制系统，PLC、RTU
	医疗科学仪器